

技術資料

FP-5023 導電銀膠

產品說明：

FP-5023 為單液型環氧樹脂導電銀膠接著劑，適用於一般中小型半導體晶片黏著。

應用：

TSOP, QFP 及 DIP...等。

產品特徵：

- 平滑、流體且不拉絲之銀膠。
- 測試金、銀及銅材質不溢膠。
- 對於不同的材質皆有良好之接著性。
- 改善 MSL3 測試之信賴性。

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	銀灰色	目視	
黏度 @ 25°C	9000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
比重	3g/cc	比重計	FT-P001
搖變指數	4.8	Brookfield DV-III/CP-51	FT-P008
@ 25°C		黏度. @ 0.5rpm/黏度 @ 5rpm	
細度	< 20 μ m	細度計	FT-P026
水含量	< 0.5 %	水份計	FT-P002
使用壽命 @ 25°C	48hrs		FT-P024
保存期限 @ -40°C	12 個月	黏度升高 25% @ 5rpm	FT-P018
烘烤條件		測試條件	
標準烘烤條件		20~30 分鐘升溫至 150°C，並在 150°C 持溫 60 分鐘。(烘箱烘烤)	
其他烘烤條件		20~30 分鐘升溫至 175°C，並在 175°C 持溫 30 分鐘。(烘箱烘烤)	
硬化時之熱重損失	<3.5%	TGA	FT-P010
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	12.0 kg/die	晶片尺寸 2mm × 2mm (銀支架)	FT-M012
@150°C	2.0 kg/die		

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

FP-5023 導電銀膠

物理及化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度 (Tg)	89°C	DMA 阻尼峰,三點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數	<Tg 44ppm/°C >Tg 212 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數			
@60°C	4491MPa		
@25°C	4085MPa	DMA, 試片厚度<1.6mm	FT-M019
@150°C	162MPa		
@250°C	178MPa		
熱重損失 @300°C	0.32 %	Thermogravimetric Analysis	FT-P010
離子含量			
Cl ⁻	5 ppm	Teflon flask, 20~40 mesh, 5g sample in 50g DI water, 24hr@100°C	FTC-021
Na ⁺	2 ppm		
K ⁺	Not detected		
熱/電性質		測試條件	測試方法
體積電阻	0.0001Ω-cm	四點探針	FT-P017
熱傳導係數	3.1W/mK	Hot Disk	FT-P022

p.s.此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）